

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **QFP20-144PIN / Halogen free**

JEITA Package name; **P-LQFP144-2020-0.50**

Lead frame plating; **Lead(Pb) Free**

Weight; **1.38 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content ※2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	12.7	シリコン	7440-21-3	12.7	999914	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.00003	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.00006	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.0003	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.00006	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.00003	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.0003	20	配線材
			タングステン ※3	7440-33-7	0.0004	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.00003	2	配線材
	保護膜	0.25	ポリイミド	-	0.25	1000000	保護膜 ※4
パッケージ	ダイアタッチ材	2.15	銀	7440-22-4	1.96	910000	主成分
			アクリル樹脂	-	0.15	70000	接着剤
			エポキシ樹脂	-	0.04	20000	接着剤
	端子メッキ	6.71	錫	7440-31-5	6.7	1000000	鉛フリーはんだ
	リードフレーム	387.52	銅	7440-50-8	366.21	945000	導体材
			銀	7440-22-4	1.94	5000	インナーリードメッキ
			その他成分 ※5	-	19.4	50000	添加剤
	ボンディングワイヤー	2.18	銅	7440-50-8	2.18	1000000	導体材
	モールド樹脂	968.49	エポキシ樹脂	-	48.42	50000	主成分
			フェノール樹脂	-	48.42	50000	硬化促進剤
			シリカ	60676-86-0	868.74	897000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	2.91	3000	樹脂着色剤

化学物質の情報について

※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。

※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。

従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。

※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。

※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。

※5 ニッケル、亜鉛、錫、ケイ素、鉄、酸化亜鉛が含まれます。